

深圳市人民政府办公厅文件

深府办规〔2019〕4号

深圳市人民政府办公厅关于印发加快集成电路产业发展若干措施的通知

各区人民政府，市政府直属各单位：

《关于加快集成电路产业发展的若干措施》已经市政府同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

市政府办公厅

2019年4月23日

关于加快集成电路产业发展的若干措施

为贯彻落实《国家集成电路产业发展推进纲要》，《中共深圳市委关于深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神加快高新技术产业高质量发展更好发挥示范带动作用的决定》（深发〔2018〕5号）和《深圳市人民政府印发关于进一步加快发展战略性新兴产业实施方案的通知》（深府〔2018〕84号），推进深圳集成电路产业重点突破和整体提升，实现跨越式发展，为深圳朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向前行，努力创建社会主义现代化强国的城市范例提供有力支撑，制订如下措施。

一、支持健全完善产业链

（一）专项支持重大项目。支持具有国际竞争力的集成电路企业在深圳设立研发中心和投资产业化项目，具体奖励、支持措施可报市政府专项审议。

（二）支持企业做大做强。深圳集成电路企业年度营业收入首次突破1亿元、3亿元、5亿元、10亿元、20亿元的，分别给予企业核心团队100万元、200万元、300万元、400万元、500万元的一次性奖励，每上一个台阶奖励一次。

（三）加大产业空间保障。对集成电路产业用地给予优先保障。对经市政府确定的重大集成电路项目，列入市重大产业项目实行专项用地保障。做好产业用地专场招拍挂工作，通过协同办公、并联审批集中解决项目评估、规模核定、用地选址、项目准

入等事项，提高审批效率。

二、支持核心技术攻关

（四）建设核心技术攻关载体。鼓励境内外企业、高校和科研机构共同建设核心技术攻关载体，对于成功申报国家制造业创新中心、国家技术创新中心、国家产业创新中心的，予以 1：1 配套支持。

（五）支持突破关键核心技术。每年由政府主管部门征集产品需求，遴选项目，面向全球招标悬赏任务承接团队，根据项目需求和专家评议结果，对承担并完成核心技术突破任务的单位（或联合体）给予该项技术研发费用最高 50% 的资助。

（六）支持布局前沿基础研究。鼓励高校、科研机构开展前沿技术研发，对承担集成电路领域国家科技重大专项、重点研发计划任务的单位，予以 1：1 配套支持；对承担工业转型升级项目的单位，予以 1：0.5 配套支持。配套资助中，本市配套资金和国家资助资金加总不超过项目资金总额的一半。对获得国家最高科学技术奖的，给予获奖人 1000 万元的一次性奖励；对获得国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科技进步奖特等奖、一等奖、二等奖的获奖人或牵头实施单位，分别给予 300 万元、200 万元、100 万元的一次性奖励。

三、支持新技术新产品研发应用

（七）支持公共服务平台建设。对集成电路设计、制造、封测公共服务平台提供 EDA（电子设计自动化）工具和 IP（知识产权）核、设计解决方案、先进工艺流片、先进封测服务、测试验

证设备等用于深圳企业开展高端芯片研发支撑服务的，一次性给予平台实际建设投入20%的资助，最高资助总额不超过3000万元。根据平台运行服务的情况，按主营业务收入的10%给予奖励，每年最高不超过1000万元。

（八）加强对设计企业流片支持。对于使用多项目晶圆进行研发的设计企业，给予多项目晶圆直接流片费用最高70%、年度总额不超过300万元的资助。对于首次完成全掩膜工程产品流片的企业，给予流片费用最高50%、年度总额不超过500万元的资助。

（九）加强对设计企业购买设计工具支持。对集成电路设计企业购买EDA设计工具软件的，按照实际发生费用的20%给予资助，每个企业年度总额不超过300万元。对企业购买IP开展高端芯片研发，给予IP购买实际支付费用最高20%的资助，单个企业每年总额不超过500万元。对从事集成电路EDA设计工具研发的企业，每年给予EDA研发费用最高30%的研发资助，总额不超过3000万元。

（十）鼓励推广应用。对于深圳企业销售自主研发设计的芯片，且单款芯片产品销售金额累计超过500万元的，按当年销售金额最高10%给予奖励，单款芯片产品年度奖励总额不超过500万元。支持深圳企业销售自主研发生产的集成电路关键核心设备和材料的，按照销售金额的最高30%，一次性给予不超过1000万元的奖励。

四、支持加大投融资力度

（十一）降低企业融资成本。对我市集成电路企业采用融资租赁方式开展技术改造的，按照融资租赁利息的 5 个百分点给予贴息，贴息年限最长不超过 3 年，单个项目资助最高不超过 1500 万元，且不超过企业融资成本。

（十二）鼓励企业上市募资。鼓励集成电路企业通过上市、收购控股上市公司、新三板挂牌等直接融资方式募集资金，分阶段给予最高不超过 1000 万元资助。报深圳证监局辅导并取得备案通知书的，给予最高不超过 100 万元资助；首次公开发行股票申请材料被中国证监会正式受理的，给予最高不超过 300 万元资助；首次公开发行股票，并在境内 A 股上市的，给予最高不超过 600 万元资助；在新三板成功挂牌的，给予最高不超过 200 万元资助；在境外交易所首次公开发行股票并上市的，给予最高不超过 300 万元资助。

五、支持完善人才体系

（十三）支持引进和留住人才。建立集成电路领军人才库，每年由政府主管部门遴选一流的科学家、企业家和技术专家入库。加强对各类集成电路人才的支持力度，对符合我市人才标准的科研项目带头人、技术骨干和管理人才等领军人才，在住房保障、医疗保障、子女就学、补贴奖励、创新创业等方面给予优先支持。

（十四）支持微电子学科建设。支持本市高校优先将微电子学科纳入高水平学科建设，对成功申请国家级示范性微电子学院的，由教育主管部门根据相关政策给予一次性奖励。

（十五）支持开展技能人才培养。支持集成电路企业与职业

院校、职业培训机构共建集成电路高技能人才培训基地，开展高技能人才培训。对经市人力资源保障局认定符合条件的高技能人才培训基地项目，根据项目产出效益情况给予资助。

六、其他扶持措施

（十六）支持集成电路环保配套。对集成电路制造企业建设废水、废气、固体废物等污染防治设施，给予建设费用最高 50% 的资助，资助金额最高不超过 1000 万元。

七、其他事项

（十七）本措施由市集成电路产业主管部门负责解释。各区政府（新区管委会）、深汕合作区管委会结合辖区实际，可制定本辖区集成电路产业发展政策。

（十八）本措施涉及奖补条款执行范围结合市政府工作重点确定，具体以当年发布的申请指南为准；涉及奖补比例和限额均为上限，实际奖补比例和金额受年度资金预算总量控制。

（十九）本措施自 2019 年 5 月 1 日起实施，有效期 5 年。

公开方式：主动公开

抄送：市委办公厅，市人大常委会办公厅，市政协办公厅，市纪委监委办公厅，市中级人民法院，市检察院。

深圳市人民政府办公厅

2019 年 4 月 29 日印发
